

Low Contact Wafer Transfers

High Performance Wafer Handling Products



76mm、100mm、150mm、200mm 用
型式：LCT2

薄ウエハ、脆弱な基板(GaAs) 対応

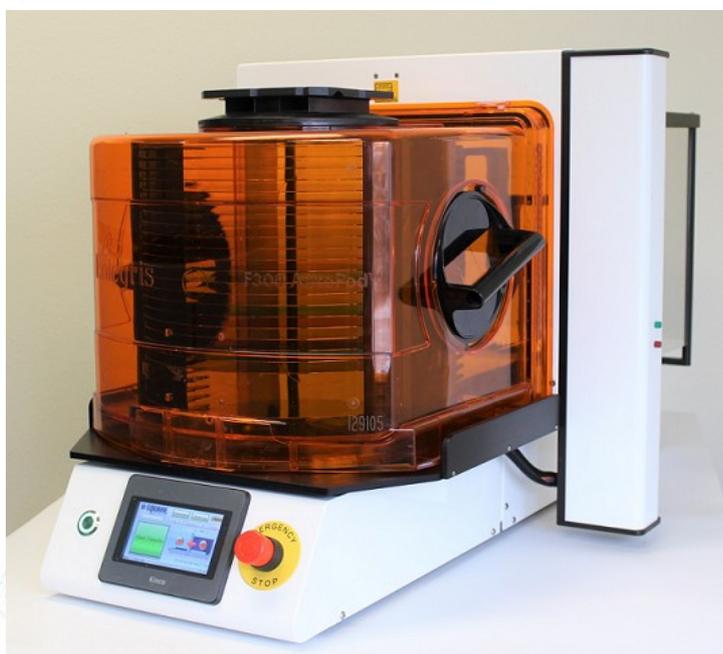
バイピッチ、極薄ウエハ(300 μ 以下)用など
カスタム品の製作も承ります



ウエハ接触部：PVDF(ポリフッ化ビニリデン)
耐摩耗性、耐薬品性に優れます

自動ウエハ水平移載装置

省スペース、高性能なローコンタクト水平移載機は
キャリア間でウエハを安全に一括移載する装置です。
プロセスキャリアからウエハを抜取り一旦保持し、
別キャリアに移し替えをします。
光及び機械センサーでエラーを監視します。
300mm 用はマッピング機能付きです。



300mm 用
型式：LCT1AS12

FOUP、FOSB、メタルカセット対応

H-SQUARE
CORPORATION

2991 Copper Road
Santa Clara, CA 95051 USA
T (408) 732-1240
F (408) 732-7970

ナガセテクノエンジニアリング株式会社

◇横浜市港北区新羽町 887

TEL 045-541-0208 FAX 045-541-0237

◇大阪市東淀川区東中島 3-5-10

TEL 06-6324-7728 FAX 06-6324-7680